

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 27 年 1 月 29 日 (2015.1.29)

【公表番号】特表 2014-500605 (P2014-500605A)

【公表日】平成 26 年 1 月 9 日 (2014.1.9)

【年通号数】公開・登録公報 2014-001

【出願番号】特願 2013-545545 (P2013-545545)

【国際特許分類】

F 2 1 S 2/00 (2006.01)

F 2 1 Y 101/02 (2006.01)

【F I】

F 2 1 S 2/00 2 1 6

F 2 1 Y 101:02

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 12 月 4 日 (2014.12.4)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

装飾照明を提供するための照明デバイスであって、  
ライトガイドを介する装飾照明のための出力面を有する前記ライトガイドに光学的に結  
合された第 1 の発光素子と、  
前記照明デバイスからの直接実用照明専用の第 2 の発光素子と、  
を含み、  
更にエンベロープによって、前記第 1 の発光素子、前記ライトガイド、及び前記第 2 の  
発光素子は封入されている、  
 照明デバイス。

【請求項 2】

前記ライトガイド及び前記第 1 の発光素子を介する前記照明デバイスからの照明は、第 1 のタイプの照明専用であり、ライトガイドなしで前記第 2 の発光素子からの前記照明デバイスからの照明は、第 2 のタイプの照明専用である、請求項 1 に記載の照明デバイス。

【請求項 3】

前記第 2 の発光素子の光強度は、前記第 1 の発光素子の光強度に対して、好適には、前記照明デバイスへの入力信号に応答して、調節可能である、請求項 1 又は 2 に記載の照明デバイス。

【請求項 4】

前記第 2 の発光素子及び前記第 1 の発光素子のうちの少なくとも 1 つは、調光可能である、請求項 1 乃至 3 の何れか一項に記載の照明デバイス。

【請求項 5】

前記第 1 の発光素子から放出された光の波長（色）は、好適には、前記照明デバイスへの入力信号に応答して、調節可能である、請求項 1 乃至 4 の何れか一項に記載の照明デバイス。

【請求項 6】

前記ライトガイドは、光ファイバ、ライトガイドプレート、又は 3 次元形状ライトガイドを含む、請求項 1 乃至 5 の何れか一項に記載の照明デバイス。

## 【請求項 7】

前記ライトガイドには、光を出力するための拡散手段が設けられている、請求項 1 乃至 6 の何れか一項に記載の照明デバイス。

## 【請求項 8】

前記出力面の構造は、前記光の散乱を調節するように選択される、請求項 1 乃至 7 の何れか一項に記載の照明デバイス。

## 【請求項 9】

前記ライトガイドは、光を出力するために粒子、及び / 又は、真空 / ガスの泡を含む、請求項 1 乃至 8 の何れか一項に記載の照明デバイス。

## 【請求項 10】

前記第 1 の発光素子及び前記第 2 の発光素子の少なくとも 1 つは、少なくとも 1 つの発光ダイオードを含む、請求項 1 乃至 9 の何れか一項に記載の照明デバイス。

## 【請求項 11】

一連の複数の発光ダイオードが前記ライトガイド内に設けられている、請求項 1 乃至 10 の何れか一項に記載の照明デバイス。

## 【請求項 12】

前記第 1 の発光素子、前記第 2 の発光素子、及び前記ライトガイドを封入する前記エンベロープを更に含む、請求項 1 乃至 11 の何れか一項に記載の照明デバイス。

## 【請求項 13】

前記第 1 の発光素子及び前記第 2 の発光素子が配置される口金を更に含む、請求項 1 乃至 12 の何れか一項に記載の照明デバイス。

## 【請求項 14】

前記口金は、従来の白熱電球をレトロフィットするために差し込み又はネジ口金を含むことを特徴とする、請求項 13 に記載の照明デバイス。

## 【請求項 15】

装飾照明を提供するための照明デバイスを製造する方法であって、  
第 1 の発光素子を提供するステップと、  
ライトガイドを介する装飾照明のための出力面を有する前記ライトガイドを提供するステップと、  
前記第 1 の発光素子を前記ライトガイドに光学的に結合するステップと、  
前記照明デバイスからの直接照明専用の第 2 の発光素子を提供するステップとを含み、  
前記第 1 の発光素子、前記ライトガイド、及び前記第 2 の発光素子を、封入するステップを更に含む方法。